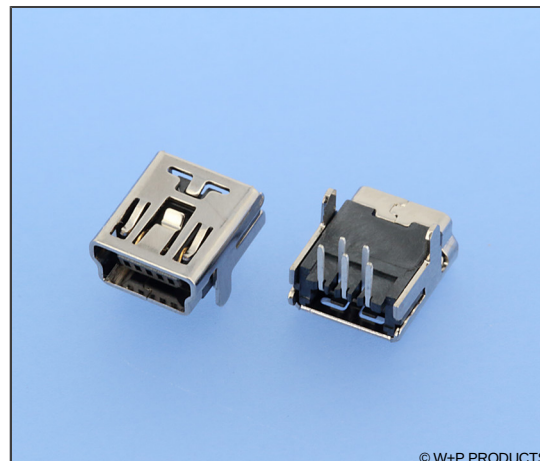


Mini-USB Steckverbinder, Typ B, Buchsen gewinkelt

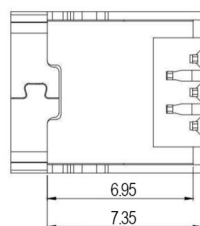
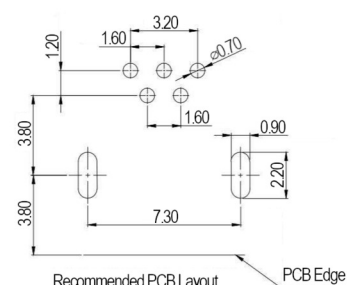
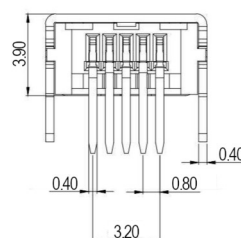
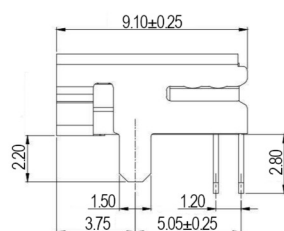
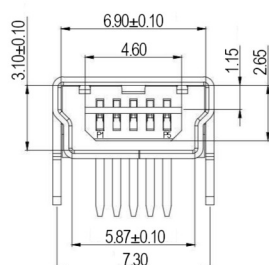
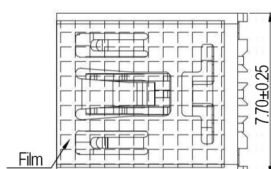
Mini-USB Connectors, Type B, Jacks Right-Angled

Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Messing, vernickelt
Shell	Nickel plated brass
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Farbe	Schwarz
Colour	Black
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktfläche	Gold über Nickel (siehe Optionen unten)
Contact Surface	Gold over nickel (see options below)
Oberfläche Lötanschluss	Zinn über Nickel
Plating Solder Side	Tin plated over nickel
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ
Contact Resistance	< 50 mΩ
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Insulation Resistance	> 100 MΩ
Spannungsfestigkeit	100 V AC
Test Voltage	100 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	-25 °C ... +85 °C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren 260 °C / 10 sec.
Processing	Reflow soldering 260 °C / 10 sec.



© W+P PRODUCTS



Series

835

Type

2

2 Type B (female)

Contacts

05

Version

2

2 Eingang seitlich
Side entry

Plating*

80

60 Sel. Au/Sn
80 Sel. Au 0,75µm/Sn (USB 2.0; C=2,1mm)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren

Fast Profile Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich T_L	230°C
Verweildauer oberhalb T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 4,5min

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature T_L	230°C
Duration above T_L	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature T_P	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 4.5min

